

01; 03; 11

© 1991

ОБ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  
 ГАЛЛИЙ-СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ *GaAs* (100)  
 В ПРОЦЕССЕ ЭПИТАКСИИ ИЗ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПУЧКОВ

С.Ю. Карпов, Ю.В. Ковалевчук,  
 Г. де ла Круз, В.Е. Мячин,  
 Ю.В. Погорельский

В настоящее время состояние поверхности полупроводников в условиях сверхвысокого вакуума принято характеризовать с помощью поверхностной фазовой диаграммы [1–3]. В случае *GaAs* (100) фазовая диаграмма в координатах „падающий поток тетramerов (димеров) мышьяка – обратная температура” представляет собой ряд областей, каждой из которых соответствует определенная реконструкция поверхности. В процессе эпитаксии из молекулярных пучков выращивание *GaAs*, как правило, осуществляется на мышьяк-стабилизированной поверхности, имеющей реконструкцию (2x4). При повышении температуры (и сохранении неизменным потока мышьяка) мышьяк-стабилизированная поверхность через промежуточную поверхностную структуру (1x1) переходит в галлий-стабилизированную поверхность с реконструкцией (4x2).

Обобщая ряд экспериментальных наблюдений, М. Паниш заметил, что высокотемпературная граница перехода к галлий-стабилизированной поверхности определяется величиной потока насыщенных паров мышьяка над жидкой фазой, находящейся в равновесии с кристаллом [1]. Это означает, что галлий-стабилизированная поверхность неустойчива относительно образования на ней жидкости. Тем самым, граница поверхностной структуры (4x2) очерчивает на фазовой диаграмме область, запрещенную для эпитаксиального роста кристаллического *GaAs*.

В данной работе предложен квазитермодинамический метод расчета границы области (4x2) поверхностной фазовой диаграммы *GaAs* (100), позволяющий описать как высокотемпературный, так и низкотемпературный ее участки. Этот метод использован для анализа возможной модификации вида фазовой диаграммы при потоках исходных компонент, сравнимых с потоками конгруэнтного испарения *GaAs*.

Будем исходить из следующих предположений: (а) – на поверхности устанавливается стационарный режим послойного роста, скорость которого ограничивается только поступлением материала из молекулярных пучков; (б) – эпитаксиальная кристаллизация снимает пересыщение на поверхности, так что десорбированные потоки галлия и мышьяка соответствуют равновесным давлениям из паров

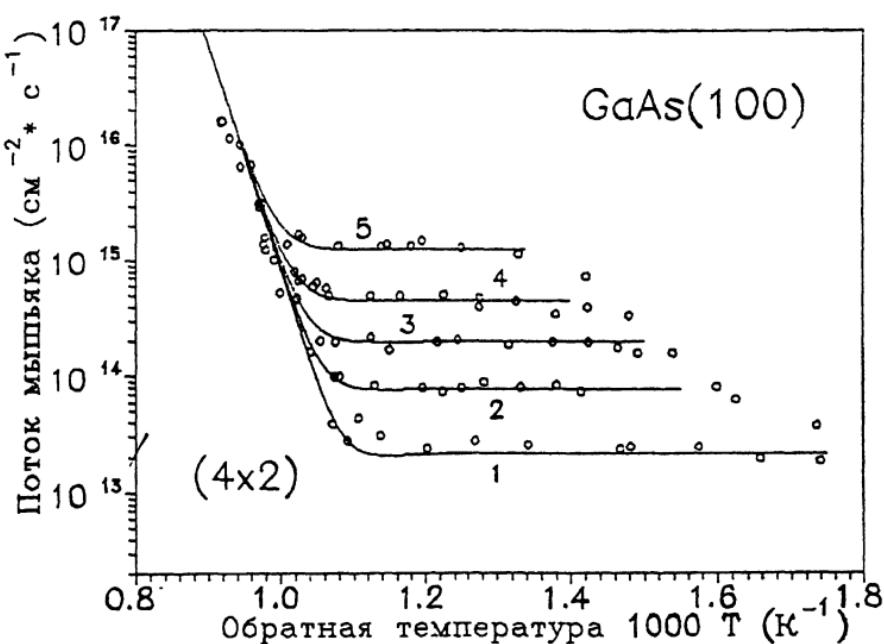


Рис. 1. Расчетная зависимость положения границы области  $(4 \times 2)$  при различных падающих потоках галлия: 1 - 0.07 МС/с, 2 - 0.25 МС/с, 3 - 0.64 МС/с, 4 - 1.45 МС/с, 5 - 4.0 МС/с. Точки - экспериментальные данные работы [3].

при данной температуре; (в) - граница области  $(4 \times 2)$  определяется трехфазным равновесием „пар-жидкость-кристалл”, при котором давления компонент зависят только от температуры поверхности.

Запишем уравнения баланса масс для галлия и мышьяка:

$$F_{Ga} - F_{Ga}^d = \delta \cdot v, \quad (1)$$

$$4(\alpha_{As} F_{As_4} - F_{As_4}^d) - 2F_{As_2}^d = \delta \cdot v, \quad (2)$$

где  $F_{Ga}$  и  $F_{As_4}$  - падающие на поверхность потоки исходных компонент;  $F_{Ga}^d$ ,  $F_{As_2}^d$  и  $F_{As_4}^d$  - десорбированные потоки;  $v$  - скорость эпитаксиального роста, измеряемая количеством монослоев  $GaAs$  в единицу времени;  $\delta = 6.245 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$  - плотность узлов анионной или катионной подрешеток на поверхности  $GaAs$  (100);  $\alpha_{As}$  - коэффициент прилипания тетрамеров мышьяка, который на границе области  $(4 \times 2)$  равен 0.5 [4] (коэффициент прилипания галлия в рассматриваемом температурном интервале равен единице, поэтому в (1) он не учитывается). При заданном потоке галлия  $F_{Ga}$  величина  $F_{As_4}$  фактически представляет собой минимальный поток, необходимый для компенсации потерь мышьяка за счет его десорбции с поверхности и кристаллизации твердой фазы.

Десорбированные потоки  $F^d$  связаны с парциальными давлениями десорбированных компонент  $P$  обычными соотношениями:

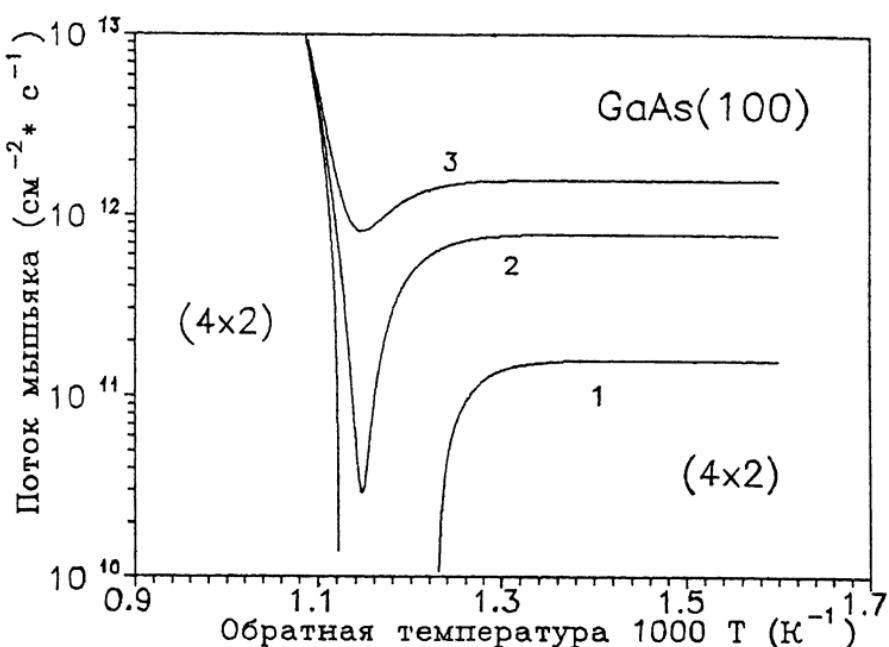


Рис. 2. Расчетная зависимость положения границы области  $(4 \times 2)$  при различных падающих потоках галлия: 1 -  $0.5 \cdot 10^{-3}$  МС/с, 2 -  $2.5 \cdot 10^{-3}$  МС/с, 3 -  $5.0 \cdot 10^{-3}$  МС/с.

$$F^d = \rho / (2\pi k M T)^{1/2}, \quad (3)$$

где  $M$  – масса молекулы (атома) пара;  $T$  – температура поверхности;  $k$  – постоянная Больцмана. В качестве давлений десорбированных компонент мы возьмем значения их парциальных давлений в случае трехфазного равновесия „пар-жидкость-кристалл”. В последнем случае давление паров галлия [5] может быть экстраполировано выражением:

$$P_{Ga} = 3.264 \cdot 10^8 \cdot \exp(-31904/T) \quad (\text{Тор}). \quad (4)$$

Парциальные давления десорбированных димеров и тетрамеров мышьяка удобно рассчитывать, исходя из соотношений

$$P_{Ga} \cdot P_{As_2}^{1/2} = R_{GaAs}, \quad (5)$$

$$P_{As_2} \cdot P_{As_4}^{-2} = R_{As}, \quad (6)$$

где  $R_{GaAs}$  и  $R_{As}$  – константы равновесия реакций образования  $GaAs$  и тетрамеров мышьяка, зависящие только от температуры [5, 6]:

$$R_{GaAs} = 3.460 \cdot 10^{15} \cdot \exp(-53817/T) \quad (\text{Тор}^{3/2}), \quad (7)$$

$$R_{As} = 8.170 \cdot 10^{-10} \cdot \exp(26474/T) \quad (\text{Top}^{-1}). \quad (8)$$

Решая систему уравнений (1)-(2) при заданном внешнем потоке  $F_{Ga}$ , можно получить величину  $F_{As_4}$ , температурная зависимость которой в нашем случае соответствует границе области (4x2).

На рис. 1 точками представлены экспериментальные данные по положению границы области (4x2), полученные при разных падающих потоках галлия [3]. Сплошными кривыми показаны результаты расчета по формулам (1)-(8). Как видно, расчетные данные достаточно хорошо описывают поведение фазовой границы. При высоких температурах граница области (4x2) определяется потоком мышьяка, компенсирующим его десорбцию с поверхности. При низких температурах, когда десорбция становится неэффективной, поступающий на поверхность поток мышьяка находится в стехиометрическом соотношении с падающим потоком галлия.

При малых падающих потоках галлия вид границы области (4x2) существенно изменяется (см. рис. 2). Как видно, вблизи температуры конгруэнтного испарения  $GaAs$  ( $\sim 903$  К согласно расчету) появляется провал и даже (при очень малых  $F_{Ga}$ ) - область, в которой фазовая граница отсутствует вовсе. Физическая причина такого поведения заключается в следующем. Ниже температуры конгруэнтного испарения десорбированный поток галлия превышает десорбированный поток мышьяка, то есть десорбция приводит к накоплению на поверхности элемента пятой группы. Если скорость этого накопления достаточна для компенсации падающего на поверхность потока галлия, образования жидкой фазы не происходит, и галлий-стабилизированная поверхность не возникает. Уменьшение температуры приводит к падению скорости накопления избыточного мышьяка, в результате чего компенсация падающего потока галлия не наступает, и при низких температурах граница области (4x2) появляется вновь. В случае  $GaAs$  этот эффект может наблюдаться лишь при чрезвычайно низких  $F_{Ga}$  (на 2-3 порядка меньших потока, обеспечивающего характерную скорость роста  $\sim 1$  мкс/ч.). Однако для других материалов, например, для  $AlAs$  или твердых растворов  $AlGaAs$ , имеющих более высокое давление насыщенных паров при температуре конгруэнтного испарения, можно ожидать изменения вида границы области (4x2) от представленного на рис. 1 к изображенному на рис. 2 уже при типичных ростовых потоках.

#### Список литературы

- [1] P a n i s h M.B. // J. Electrochem. Soc. 1980. V. 127. N 12. P. 2729-2733.
- [2] B a i l l a r g e o n J.N., C h e n g K.Y., H s i e h K.C. // Appl. Phys. Lett. 1990. V. 56. N 22. P. 2201-2203.

- [3] Newstead S.M., Kubiak R.A.A., Parker E.H.C. // J. Cryst. Growth. 1987. V. 81. N 1-4. P. 49-54.
- [4] Tsao J.Y., Brennan T.M., Hammons B.E. // Appl. Phys. Lett. 1988 V. 53. N 4. P. 288-290.
- [5] Arthur J.R. // J. Phys. Solids. 1967. V. 28. N 11. P. 2257-2267.
- [6] Chen J.Y., Chatillon C. // J. Cryst. Growth. 1990. V. 106. N 3. P. 543-552.

Физико-технический  
институт им. А.Ф. Иоффе  
АН СССР, С.-Петербург

Поступило в Редакцию  
4 ноября 1991 г.